

三ヘッドインダクター レーザー剥離装置

二つパーツフィーダーを使用してワークを直接載具に供給し、CCDによる高精度な位置決めを行った後、3台レーザーを同時に使用して加工することで、インダクター表面を微細加工し、顧客の加工要求を満たす効果を実現します。



製品特徴

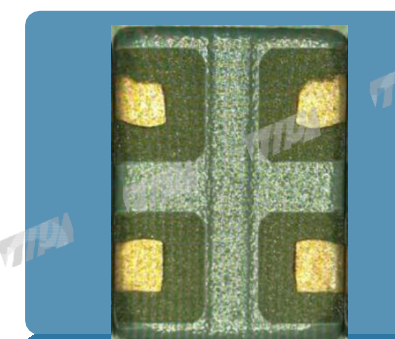
PRODUCT HIGHLIGHTS

インダクターレーザー剥離装置は、世界市場でトップクラスの販売実績を誇るレーザー光源を搭載し、高い安定性と迅速なアフターサービス対応を実現しています。

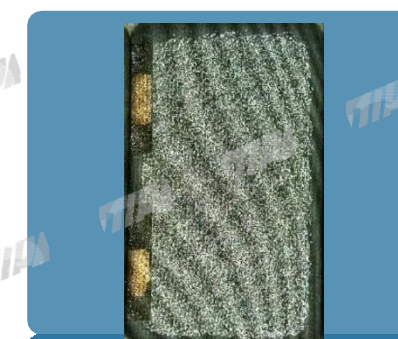
- ◆ **高精度:** 剥離精度は $\pm 0.05\text{mm}$ 以内を実現。
- ◆ **高効率:** 3台のレーザーを同時に使用することで、最大2,000PCS/H以上の処理が可能。
- ◆ **独自開発レーザー光源:** カスタマイズ可能なファイバーレーザーを採用し、最適なコストパフォーマンスを提供でき、さらに、迅速で便利なアフターサービスを実現。
- ◆ **自社開発マーキングボード:** 顧客のカスタマイズニーズに対応した専用のマーキングボードを開発・提供。

アプリケーション効果

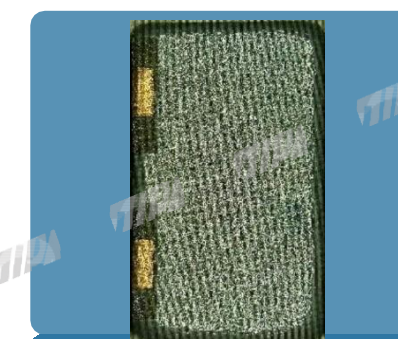
APPLICATION EFFECTS



正面



右側面



左側面

機械

MECHANICAL

項目	規格	オプション
設備型番	HiPA-LP-IR30-III	/
設備サイズ	1500mm × 1200mm × 1800mm	/
重量	1200kg	/
ワーク供給方式	自動供給	/
ワークサイズ	8mm × 5mm × 6mm	顧客製品の寸法に応じてカスタマイズ可能
除塵構造	アヒル口式除塵構造	/
治具	取替方式	/
ノイズ	≤75db	/

電気

ELECTRICAL

項目	規格	オプション
定格電圧	単相 AC 220V 50/60Hz	/
定格電流	16A	/
定格パワー	3.5kW	/

レーザー

LASER&PROCESS

項目	規格	オプション
製品仕様	080506	顧客の製品サイズに応じてカスタマイズ可能
剥離要求	三面インダクターレーザー剥離装置	/
剥離精度	±0.05mm	/
レーザーパラメーター	IR 30W	UV 15W
ガルバノスキャン範囲	F254	/
ガルバノスキャン速度	1mm/s~7000mm/s	/
ガルバノ重複位置決め精度	0.01mm	/
マーキングカード	JPT 自作	/

視覚

VISION

項目	規格	オプション
カメラ	HiPA-CS5472-5GM	/
レンズ	MFA110-H50	DTCM110-110-AL
単ピクセル精度	15μm	15μm
位置決め精度	45μm	45μm